

平成27年3月期

第2四半期決算説明資料



株式会社 石井工作研究所
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

<http://www.i-kkco.jp>



決算説明資料の構成

1. 平成 27 年 3 月期第 2 四半期決算概要
2. 平成 27 年 3 月期通期業績予想
3. 会 社 概 要
4. セグメント別技術・新製品開発



1. 平成27年3月期第2四半期決算概要

1. 平成27年3月期第2四半期決算概要



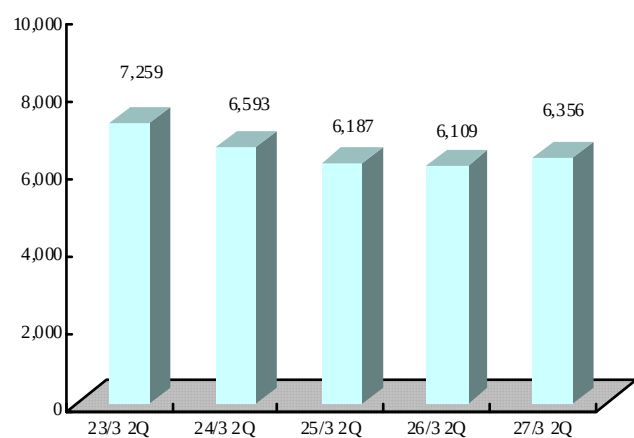
1. 最近5年間の業績の推移

回 次	第 33 期	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期
決 算 年 月	第2四半期	第2四半期	第2四半期	第2四半期	第2四半期
売 上 高 (千円)	1,521,333	1,147,867	1,116,375	1,251,282	1,558,418
売 上 総 利 益 (千円)	419,813	63,146	118,744	18,227	54,682
販 売 管 理 費 及 び 一 般 管 理 費 (千円)	345,966	311,045	287,874	249,977	226,972
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 (△) (千円)	73,846	△247,899	△169,130	△231,749	△172,289
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) (千円)	120,015	△224,462	△158,137	△213,303	△158,641
四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 (△) (千円)	141,316	△194,271	△223,767	△106,684	△188,107
資 本 金 (千円)	1,186,300	1,186,300	1,186,300	1,186,300	1,186,300
発 行 済 株 式 総 数 (千株)	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
純 資 産 (千円)	6,108,625	5,561,052	5,133,359	4,891,732	4,882,788
総 資 産 (千円)	7,259,106	6,593,115	6,187,224	6,109,240	6,356,448
1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)	785.86	715.42	660.43	629.37	628.24
1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 (△) (円)	18.18	△24.99	△28.79	△13.73	△24.20
自 己 資 本 比 率 (%)	84.2	84.3	83.0	80.1	76.8
営業活動によるキャッシュフロー (千円)	390,069	△187,125	38,086	2,060	△422,961
投資活動によるキャッシュフロー (千円)	65,188	9,066	△135,870	171,881	△4,728
財務活動によるキャッシュフロー (千円)	△172	△76,947	△46,335	△46,272	370,567
現金及び現金同等物残高 (千円)	2,226,790	1,740,949	1,289,790	1,182,487	885,028
従 業 員 数 (名)	270	263	256	246	243

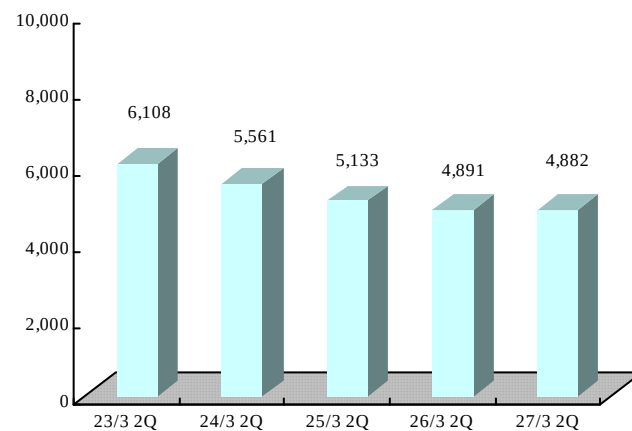


財務状態 Financial Condition

総資産 Total assets (百万円/¥Millions)

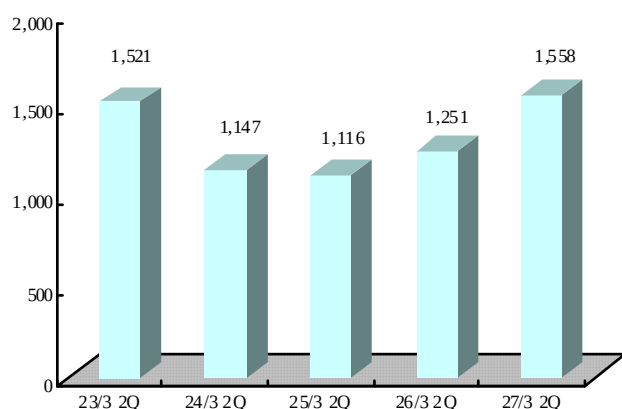


純資産 Shareholders' equity (百万円/¥Millions)

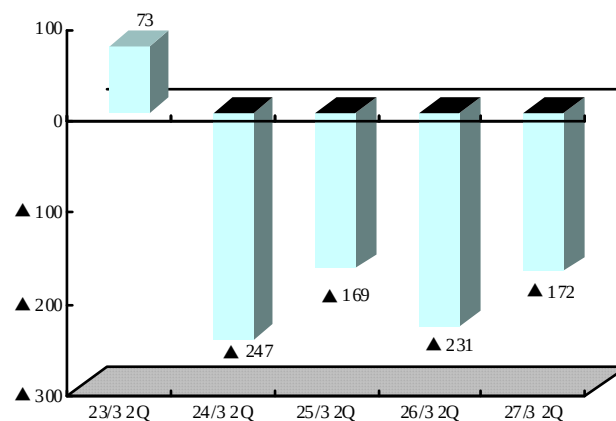


業績推移 Operating results

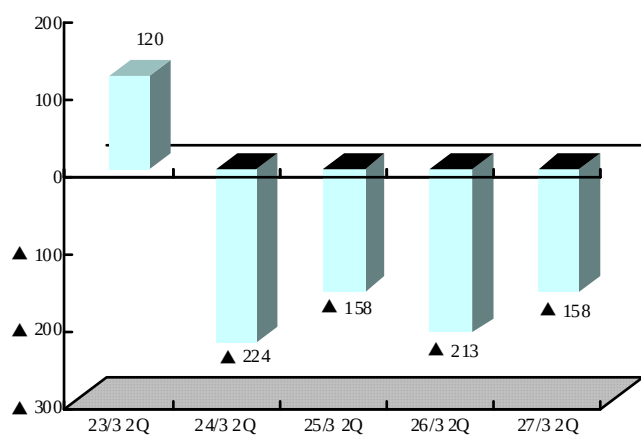
売上高 Net sales (百万円/¥Millions)



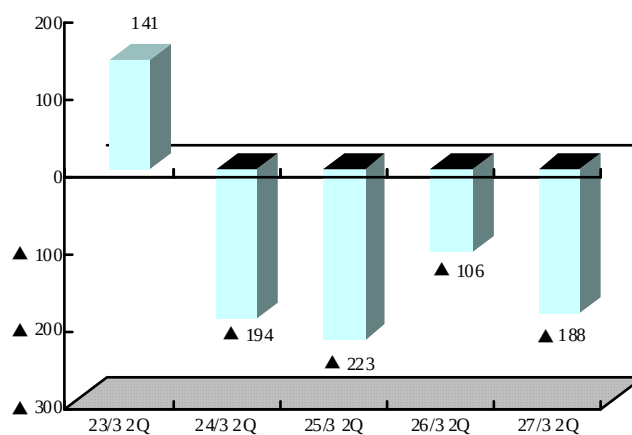
営業利益又は損失 Operating income/loss (百万円/¥Millions)



経常利益又は損失 Ordinary income/loss (百万円/¥Millions)

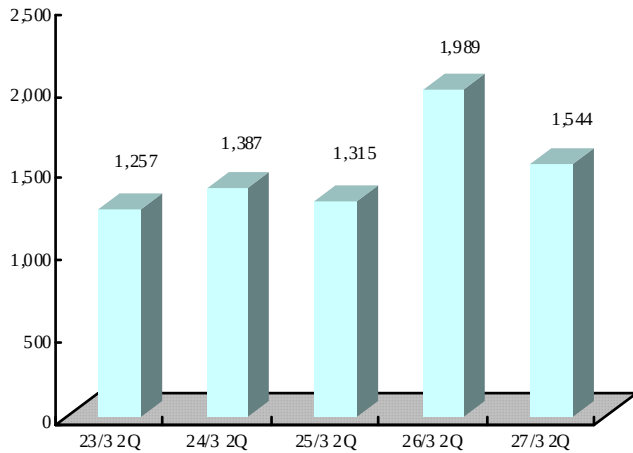


四半期純利益又は純損失 Net income/loss (百万円/¥Millions)

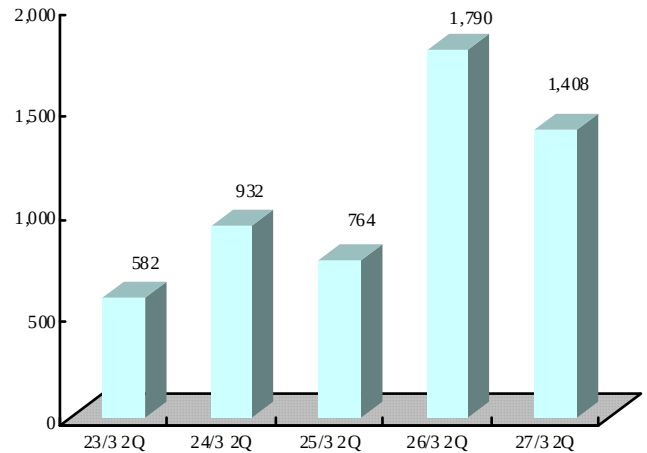




受注高 Order received (百万円/¥Millions)

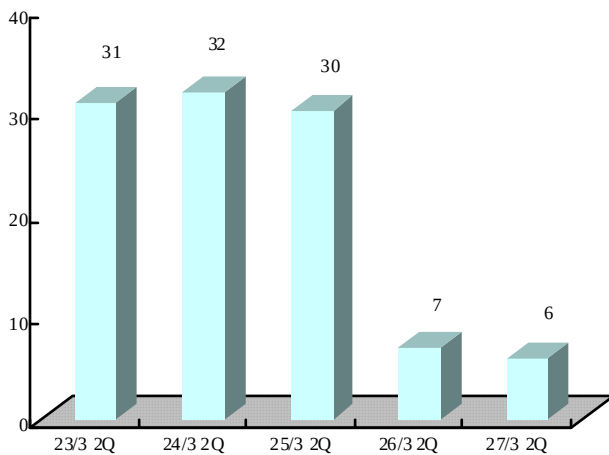


受注残高 Order backlog (百万円/¥Millions)

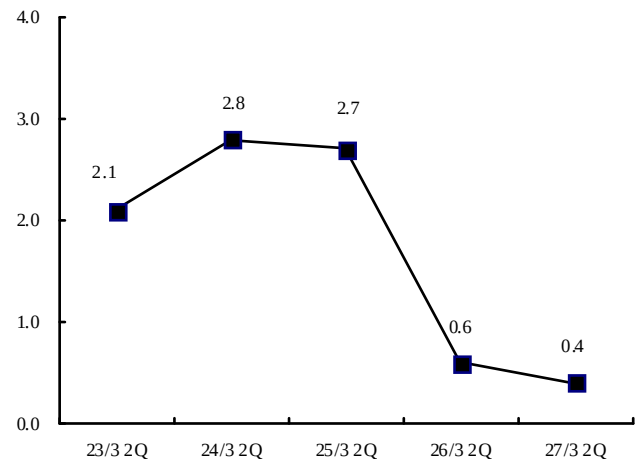


設備投資額・研究開発費等指標 Capital expenditures/Research and development expenses Data

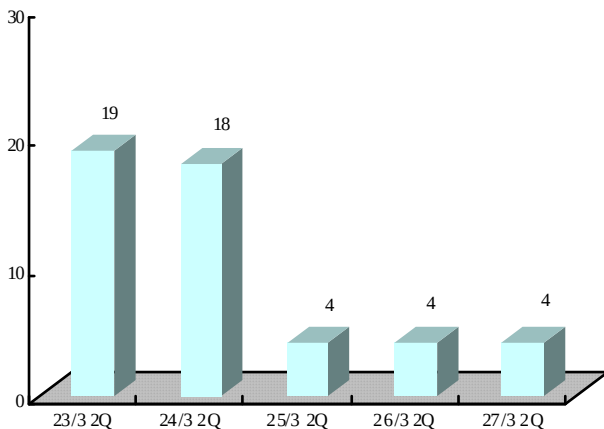
研究開発費 Research and development expenses (百万円/¥Millions)



研究開発費の対売上比率 Ratio of sales to research and development expenses (%)

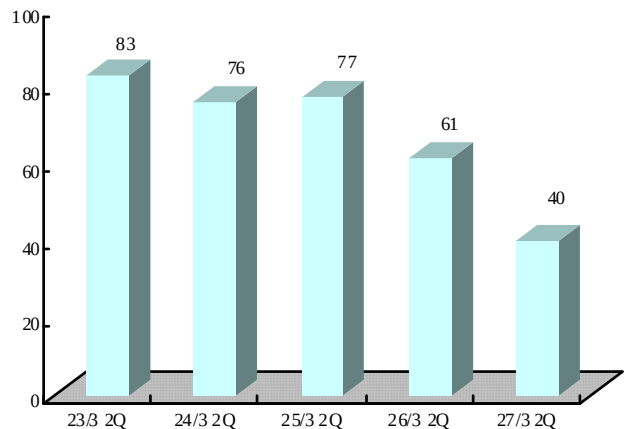


設備投資額 Capital expenditures (百万円/¥Millions)



注 リース取得価額相当額を含む

減価償却費 Depreciation (百万円/¥Millions)

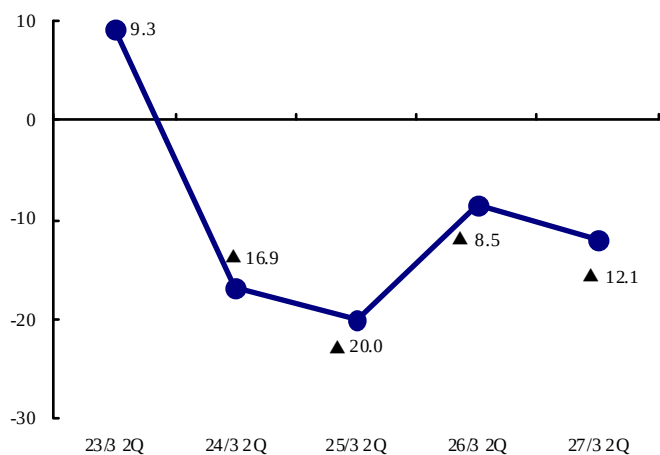


注 支払リース料における減価償却費相当額を含む

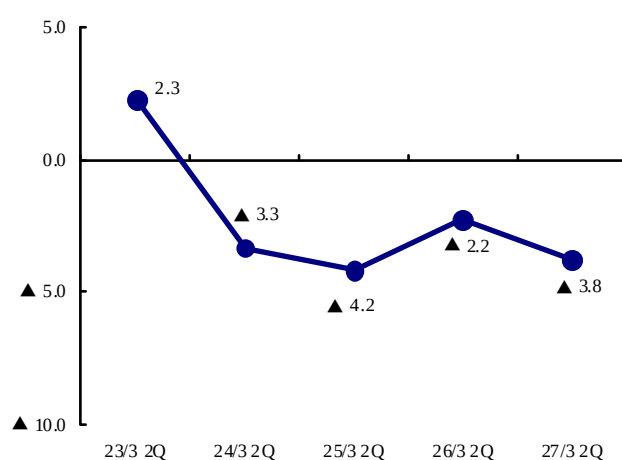


収益性指標 Profitability

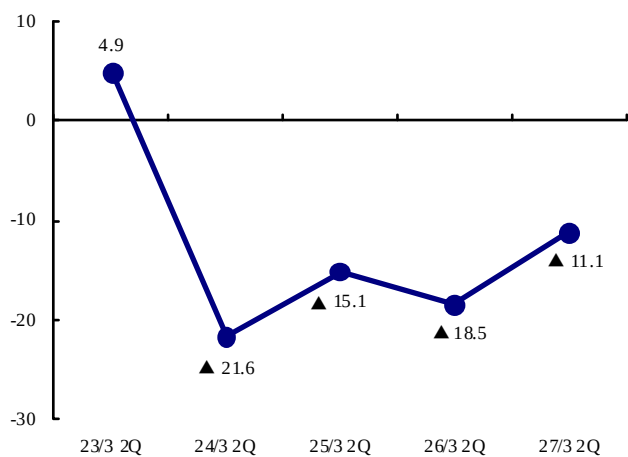
売上高純利益率 Net income to net sales (%)



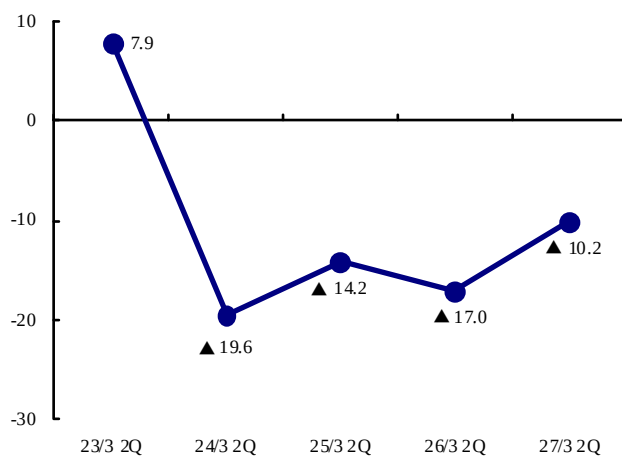
自己資本利益率 Return on equity (%)



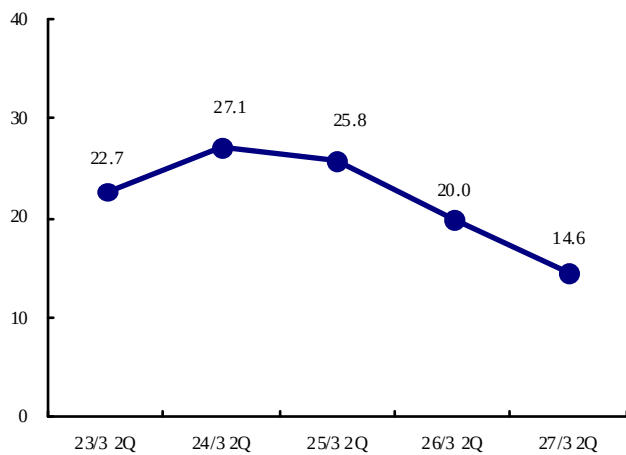
売上高営業利益率 Operating income to net sales (%)



売上高経常利益率 Ordinary income to net sales (%)



販管費の対売上比率 Ratio of sale to selling, general and administrative expenses (%)

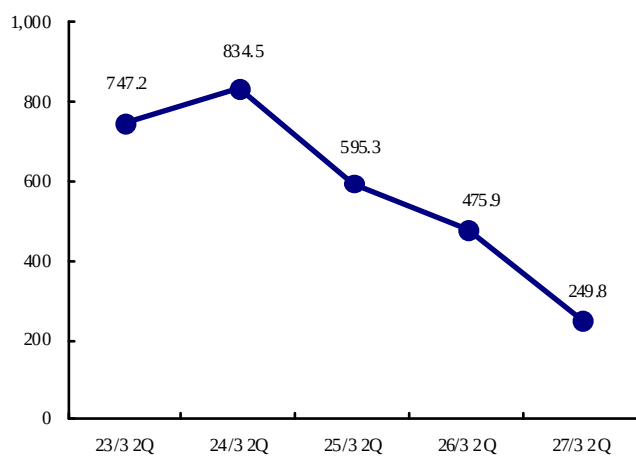




安定性指標 Financial stability

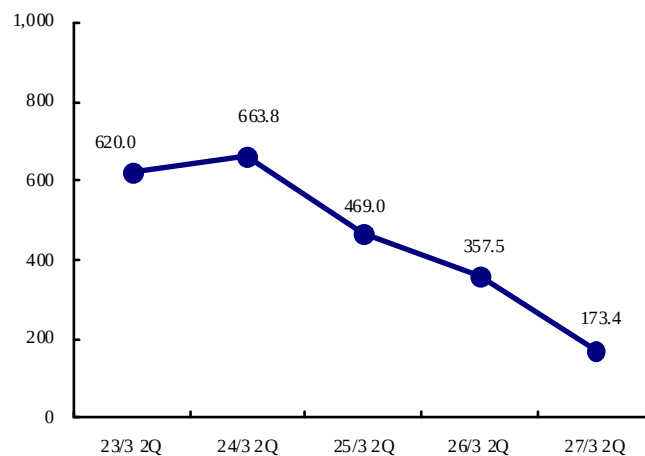
流動比率 Current ratio

(%)



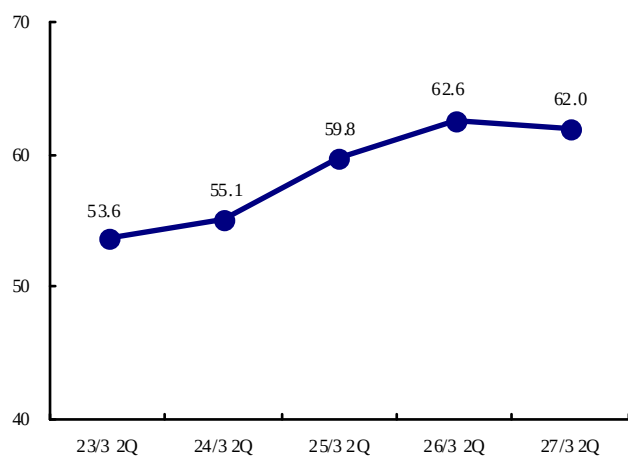
当座比率 Quick ratio

(%)

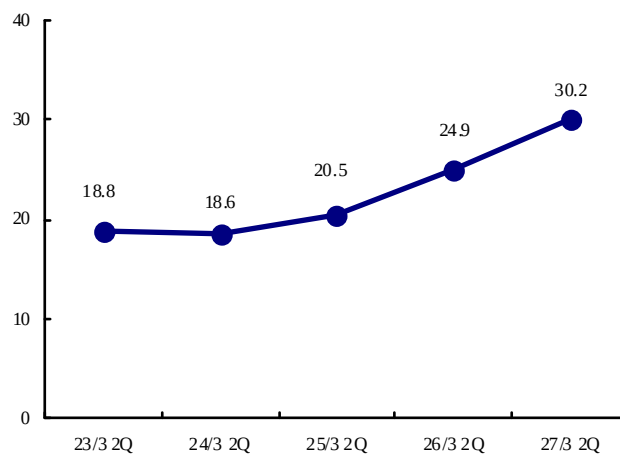


固定比率 Fixed assets ratio

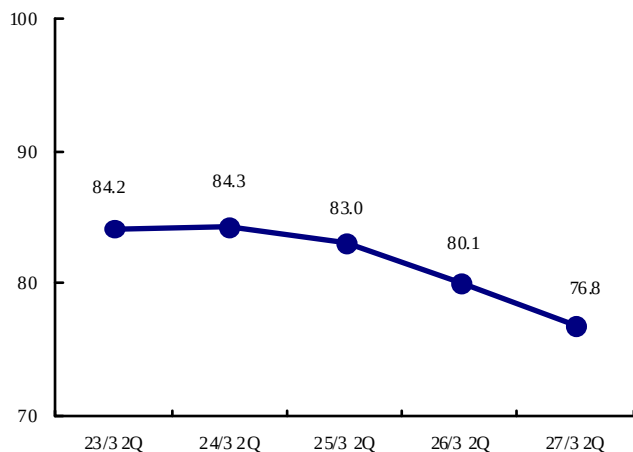
(%)



負債比率 Liabilities to shareholders' equity ratio (%)



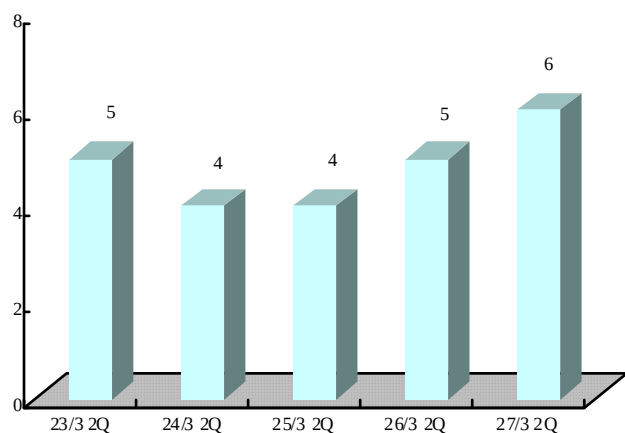
自己資本比率 Shareholders' equity to total assets(%)





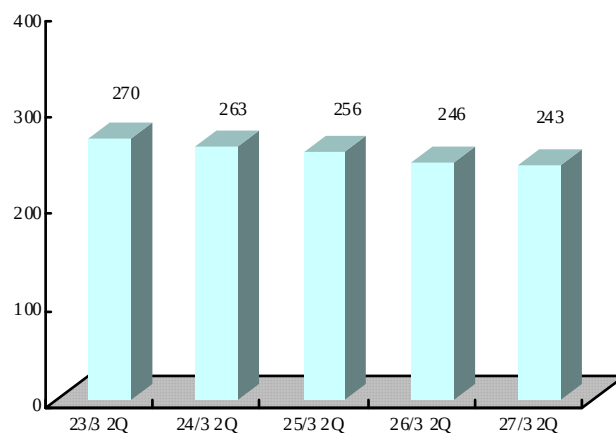
従業員 1 人当たり指標 Per employee Data

従業員 1 人当たり売上高 Net sales per employee (百万円/¥Millions)



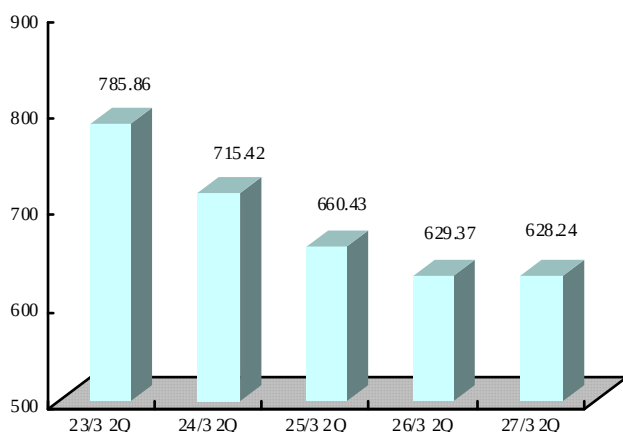
従業員数 Number of employees

(人/persons)

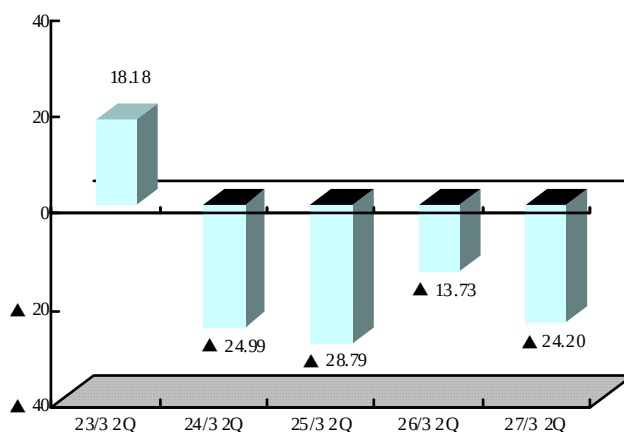


1 株当たり指標 Per share Data

1 株当たり純資産額 Shareholders' equity per share (円/¥)



1 株当たり四半期純利益 Net income per share (円/¥)





2. セグメント別 販 売 実 績

セグメントの名称	販 売 高	前年同四半期比(%)
半 導 体 関 連 事 業(千円)	1,515,291	135.6
不動産・建築関連事業(千円)	43,126	32.1
合 計 (千円)	1,558,418	124.5

(注) 1. 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、当該割合が 100 分の 10 未満の場合は記載を省略しております。

相 手 先	前第2四半期累計期間		当第2四半期累計期間	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
第 一 実 業 (株)	655,438	52.4	573,749	36.8
三 菱 電 機 (株)	—	—	384,137	24.6

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. セグメント別 受 注 状 況

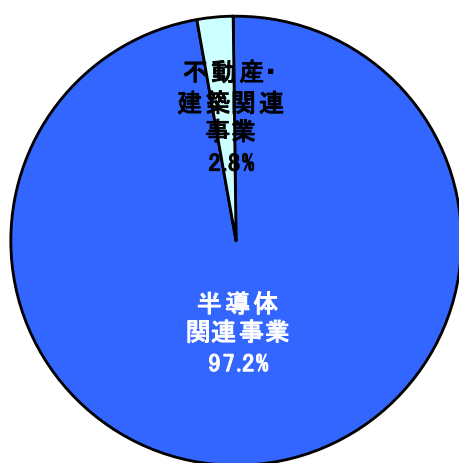
セグメントの名称	受注高 (千円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同四半期比 (%)
半 導 体 関 連 事 業	1,428,058	75.2	1,293,771	76.0
不動産・建築関連事業	116,450	129.8	115,211	129.0
合 計	1,544,508	77.6	1,408,982	78.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

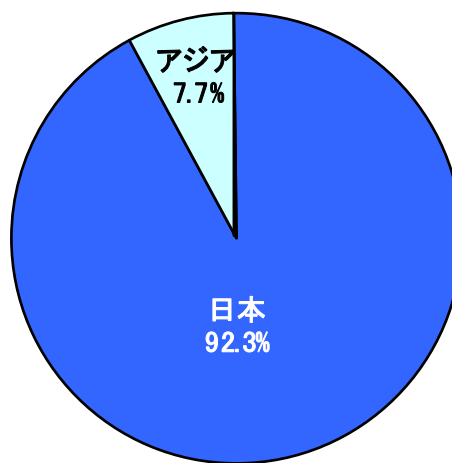


売上高及び受注高構成（27年3月期第2四半期）

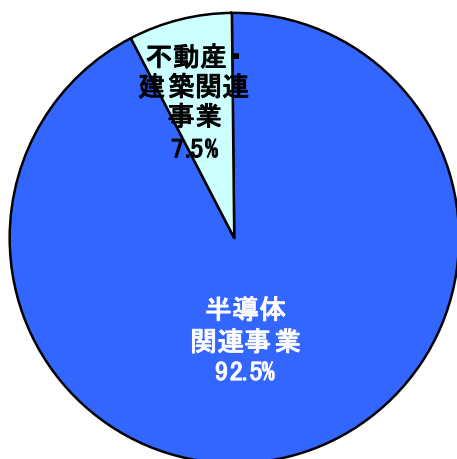
セグメント別売上高



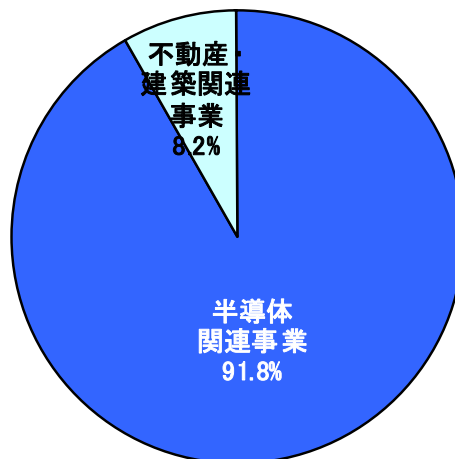
地域別売上高



セグメント別受注高



セグメント別受注残高





2. 平成27年3月期業績予想



第37期(平成27年3月期)の利益計画

a. 利 益 計 画 表

(単位:千円)

期 別 項 目	第36期 (26年3月期)		第37期予想 (27年3月期)		増 減
売 上 高	3,089,711	100.0	3,200,000	100.0	110,289
売 上 原 価	2,642,525	85.5	2,990,000	93.4	347,475
売 上 総 利 益	447,186	14.5	210,000	6.6	△237,186
販売管理費及び一般管理費	490,153	15.9	450,000	14.1	△40,153
営 業 損 失 (△)	△42,966	△1.4	△240,000	△7.5	△197,034
営 業 外 収 益	31,240	1.0	23,400	0.7	△7,840
営 業 外 費 用	1,349	0.0	2,600	0.1	1,251
経 常 損 失 (△)	△13,076	△0.4	△219,200	△6.9	△206,124
特 別 利 益	93,537	3.0	35,444	1.1	△58,093
特 別 損 失	113	0.0	9,244	0.3	9,131
税引前当期純損失(△)	80,347	2.6	△193,000	△6.0	△273,347
法 人 税 及 び 住 民 税	8,163	0.3	5,000	0.2	△3,163
法 人 税 等 調 整 額	△27,983	△0.9	42,000	1.3	69,983
当 期 純 損 失 (△)	100,166	3.2	△240,000	△7.5	△340,166

b. 販売高のセグメント別内訳

(単位:千円)

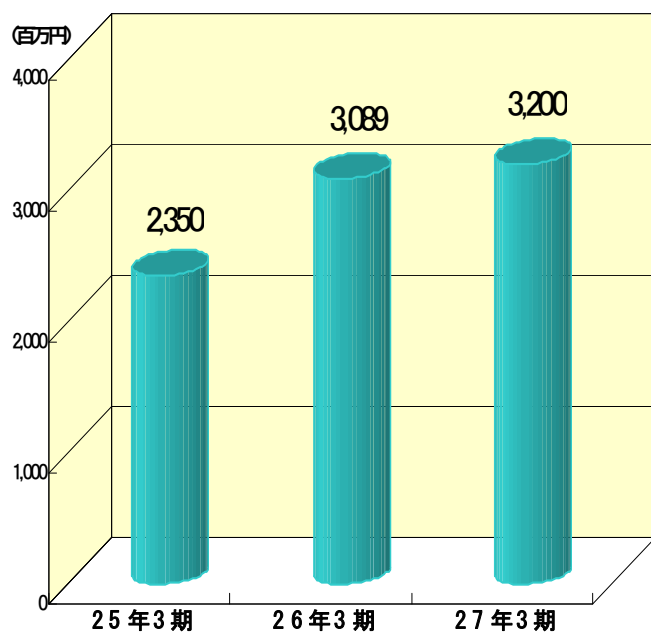
期 別 セグメントの名称	第36期 (26年3月期)	第37期予想 (27年3月期)	増 減
半 導 体 関 連 事 業	2,853,702	3,040,000	186,297
不 動 産 ・ 建 築 関 連 事 業	236,008	160,000	△76,008
合 計	3,089,711	3,200,000	110,288

(注)本資料に掲載されている業績予想、見通し、事業戦略につきましては、現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

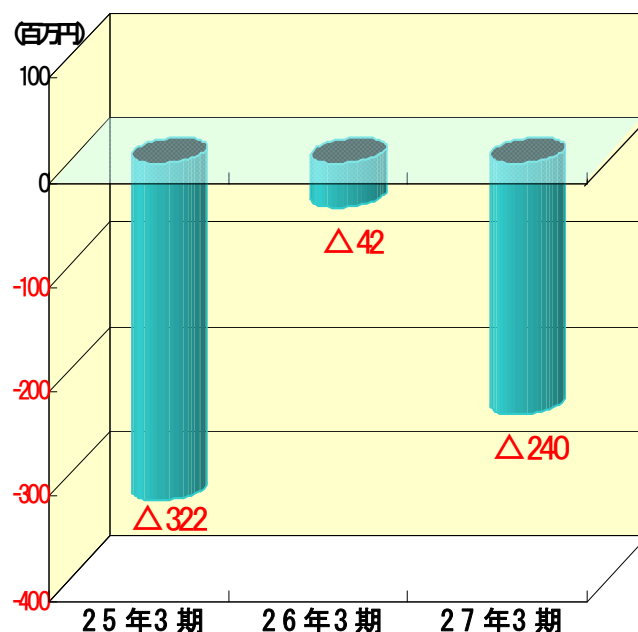


27年3月期の目標

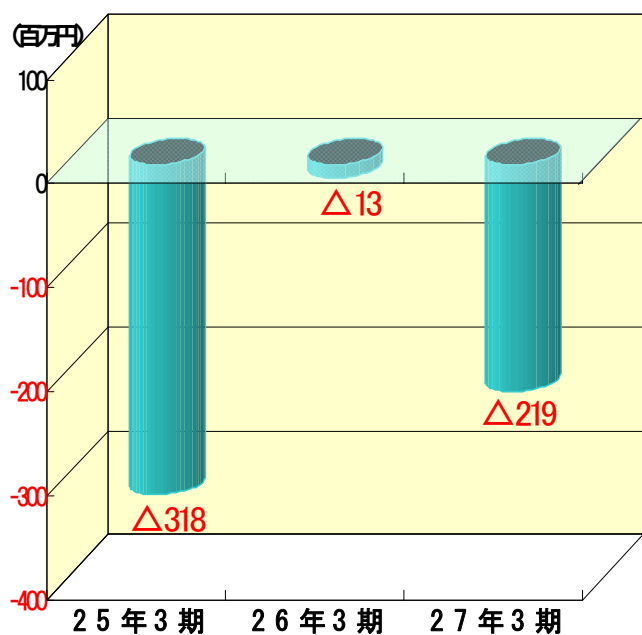
売上高



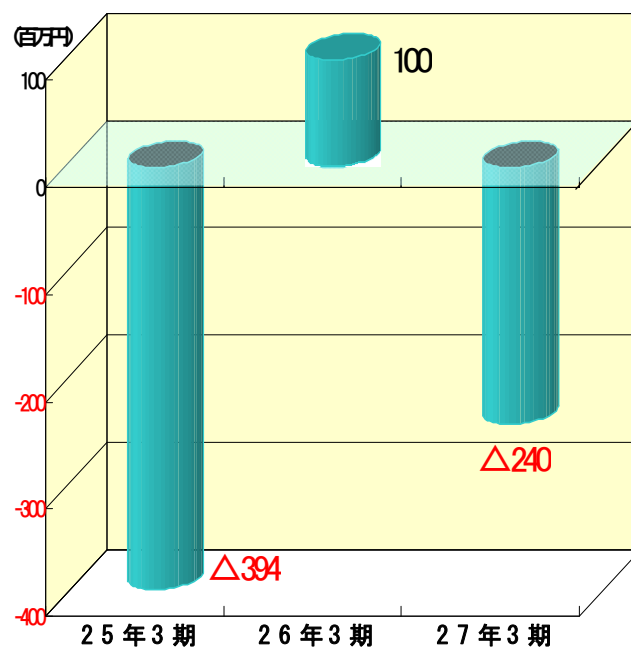
営業損失



経常損失



純利益又は純損失





ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

3. 会社概要

1. 当社の経営基本方針

当社は、「たゆまず前進する技術と創意工夫によって社会に貢献する」ことを経営理念としております。そして、「正しい見識を持って意欲的に即行動し新しい価値を生む」ことを行動理念とし、「ユーザーに深く感謝する精神で早く良いものを安くに徹する」ことを経営方針として業務に取り組んでおります。

当社は、半導体関連事業として半導体製造後工程装置やその精密金型の開発、設計、製造及び販売を行なっており、低騒音、省エネルギー、省スペース（小型化）をコンセプトとして切断・成形、マーキング、製品検査等を対象領域とする機器を提供しております。

また、主事業である半導体関連事業に加えて、個人住宅の建築販売及びホームエレベータの製造販売・太陽光発電装置の販売を行なう不動産・建築関連事業の展開・拡大に努めます。



2. 会社の概要

商 号 株式会社 石井工作研究所
(英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION.)

本 店 大分県大分市東大道二丁目5番60号

設立年月日 昭和54年(1979年)1月5日

事業内容

セグメント の名称	区 分	主 要 営 業 品 目
半 導 体 関 連 事 業	半 導 体 関 連 製 造 装 置 及 び 金 型	リード加工機 (BGA・CSP個片カット装置を含む) リード加工金型
	加 工 部 品	プラスチック成型加工品 プレス加工品 金属加工部品
	電 装 品	マイクロコンピューター 電装装置
	そ の 他	購入品 補修サービス
不動産・建築 関 連 事 業	マ ン シ ョ ン 及 び 住 宅	個人住宅・住宅用ホームエレベータ 太陽光発電装置

資 本 金 1,186,300,000 円 (平成26年9月30日現在)

株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株

発行済株式総数 7,800,000株 (平成26年9月30日現在)

1単元の株式数 100株

決 算 期 3月31日 (年1回)

役 員 代表取締役社長 石 井 仁 海

取締役 石 井 光 明

取締役 重 松 秀 信

取締役 時 枝 典 生

監査役 (常勤) 衛 藤 良 一

監査役 姫 野 昭 雄

監査役 伊 東 徳 (平成26年10月1日現在)

従 業 員 数 243名 (平成26年9月30日現在)

(従業員には、臨時従業員 (準社員) を含んでおりません。)

主要取引銀行 株式会社 大 分 銀 行 本 店

株式会社 三井住友銀行 大 分 支 店

三井住友信託銀行株式会社 大 分 支 店



大 株 主

(平成26年9月30日現在)

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持 株 比 率
有 限 会 社 テ ク ト ロ ン	1,660 ^{千株}	21.35 [%]
石 井 見 敏	1,157	14.89
石 井 工 作 研 究 所 会 従 業 員 持 株 会	882	11.36
石 井 見 紀	183	2.35
松 井 証 券 株 式 会 社	175	2.26
石 井 光 明	149	1.92
石 井 仁 海	138	1.78
株 式 会 社 大 分 銀 行	124	1.60
有 泉 洋	111	1.42
松 浦 兼 昭	61	0.78

(注) 持株比率は、自己株式(27,826株)を控除して計算しております。

3. 会社の沿革

年 月	概 要
昭和 54 年 1 月	(株)石井工作研究所設立(資本金 10,000 千円)。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業を開始。本社及び本社工場(旧大分工場)を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。
昭和 54 年 6 月	金属及び非金属材料販売を行なうため丸善通商(株)設立。
昭和 55 年 10 月	数値制御による機械加工を集約するため(株)大分エヌシーセンター設立。
昭和 56 年 4 月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。
昭和 56 年 5 月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に(有)石井工研産業設立(後、株式会社へ組織変更)。
昭和 58 年 12 月	丸善通商(株)を(株)九栄システム(現北九州工場)に商号変更するとともに本社を北九州市門司区に移転。
昭和 59 年 1 月	業容の拡大と合成樹脂製品製造、販売のため、大分県テクノポリス地域の指定を受けた大分県杵築市に杵築工場開設。
昭和 60 年 2 月	関西及び関東以北での販売を強化するため、大阪事務所を大阪市北区に東京事務所を東京都新宿区に開設。
昭和 61 年 3 月	半導体組立工程の5工程(①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類)を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD300」を(財)大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。
昭和 61 年 8 月	半導体製造用の低騒音、超小型のNCモータープレスの「ソフトプレス」を開発。
昭和 61 年 11 月	日本国内での販売を強化し、新製品販売促進のため東京晴海での半導体製造装置展示会“セミコン・ジャパン 86”に初めて出展。
平成 3 年 10 月	経営の合理化と経営効率を図るため、(株)大分エヌシーセンター、(株)九栄システム及び(株)石井工研産業を吸収合併。
平成 4 年 3 月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体製造の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」(協和(現りそな)中小企業振興財団・日刊工業新聞共催)を受賞。
平成 4 年 9 月	「IC検査用画像処理装置」を開発。
平成 5 年 7 月	アメリカでの世界最大の半導体製造装置展示会“セミコン・ウエスト 93”に初めて出展。
平成 5 年 9 月	本社ビル完成。
平成 7 年 4 月	大阪事務所及び東京事務所を各々営業所に名称変更。
平成 8 年 8 月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。
平成 9 年 2 月	ISO9001 認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。
平成 12 年 8 月	ISO14001 認証取得。
平成 13 年 6 月	北九州工場を北九州市小倉北区に土地・建物を取得して移転。
平成 13 年 8 月	不動産事業を開始。
平成 14 年 1 月	浄水事業を開始。
平成 15 年 11 月	大分曲工場第一期工事完成。
平成 16 年 12 月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成 17 年 12 月	大分曲工場第二期工事完成。
平成 18 年 2 月	大分工場、大分羽田工場の大分曲工場移転完了。
平成 18 年 7 月	本社所在地を大分県大分市東大道二丁目5番 60 号に住所表示変更。
平成 21 年 4 月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。
平成 21 年 6 月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。
平成 22 年 4 月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
平成 25 年 4 月	閉鎖していた北九州工場を売却。
平成 25 年 7 月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)に上場。
平成 26 年 5 月	当社創業者石井見敏逝去。



4. 営業所及び工場

① 本 社 大分県大分市東大道二丁目 5 番60号

② 営 業 所

東京営業所 東京都港区

熊本営業所 熊本県熊本市

③ 工 場

大分曲工場 大分県大分市

杵築工場 大分県杵築市



4. セグメント別技術・新製品開発

< 半導体関連事業 >

最新開発商品 New Product

レーザーバリ取り装置

Laser Deflashing System

- ・レーザー光でパッケージ周辺の余分なレジンバリを除去します。
- ・モールドズレを画像認識で位置補正し、高精度加工します。
- ・金型では除去が厳しい微小加工が可能で、また、金型を使用しない為、消耗部品が不要です。



大型MAP基板 レーザーマーク装置

Laser Mark System for Large size MAP

- ・製品搬送ユニットに基板反り矯正機構を持たせ、反りの有る大型MAP基板のマークに最適です。
- ・マークされた製品は静電ブロー&ブラシクリーニングされ、マーク品質を画像認識で検査します。
- ・リードフレームのマークにも対応します。



小型ハンドプレス

Table Top Hand Press

- ・高剛性角ポストを使用したコンパクト低価格なハンドプレスです。
- ・手動加圧で高圧力加工でき、半導体パッケージの個片切断、薄板の打抜き、折り曲げ等の簡易プレス工程に最適です。



大型装置（従来に比べて大型）

- ・大分曲向上完成に伴い、半導体分野以外の液晶組立装置や、車載用部品組立装置の製作を開始しました。



お問合せは、本社営業課、東京営業所、熊本営業所、または hsales@i-kk.co.jp まで。

Contact us at Headquarter sales, Tokyo sales office, Kumamoto sales office, or hsales@i-kk.co.jp for any



ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

本資料に関するお問い合わせ



株式会社 石井工作研究所
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

I R 担 当 者

TEL : 097-544-1001

E-mail : tokieda@i-kk.co.jp

<http://www.i-kk.co.jp>

<不動産・建築関連事業>

自然エネルギー

再生可能エネルギー発電設備・システム設計 / 施工 / 機器販売

大分市内某大規模太陽光発電所



エネルギー源である石油・石炭などの化石燃料は限りがあるエネルギー資源です。これに対し、太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などのエネルギーは、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギーです。これらは「再生可能エネルギー」ともいわれます。石油に代わるクリーンなエネルギーとして政府が導入・普及を促進しています。

当社は 2002 年より一般向け、産業用の太陽光発電の普及に貢献して参りました。今後も再生可能エネルギーに係る発電事業を支える企業として前進して行きます。

発電設備に係るシステム設計から造成・設置・遠隔監視システムに至るまでをトータルでサポート致します。



<施工>



<遠隔監視システム>

住環境

住宅向け省エネ設備のシステム設計 / 施工 / 機器販売

